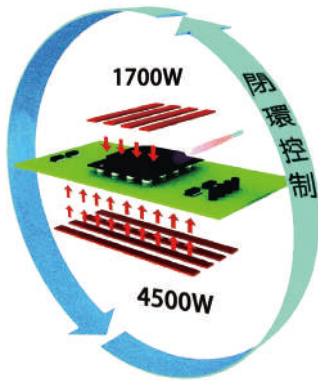


BGA3500DX-IR

BGA 全紅外線返修設備(無對位)



特點

針對工業伺服器最大 PC 板 700mm×680mm 尺寸而設計，加大型 IR 全紅外線燈管 BGA 元件返修設備。

BGA 零件返修設備所組合的 BGA 元件光學影像對位錫球熔錫 IR 全紅外線燈管返修設備，區分 3 大系統：

- 上部、底部皆為 IR 紅外線燈管發熱器，4500W 功率輸出，針對 PCB 板底部大面積的快速預熱。

採用微處理器控制和紅外線感應技術，能夠安全、精確的對表面黏著元件進行維修拆焊，並可通過拆焊溫度軟體 IR Soft 經由電腦連線，對整個維修零件的拆取、迴焊過程中進行控制，記錄其全部溫度、時間等資料，同時配置大型底部紅外線燈管加熱器，及特殊的 PC 板夾具，避免 PCB 板板翹變形。滿足現代電子工業大尺寸 PCB 板更高的溫度要求，是目前電子工業領域最具價值的維修工具。

IR 加熱系統設有 10 組工作參數模式，可編輯溫度、時間控制，針對每一種模式都可進行參數修改。IR 的具體控制皆由外部鍵盤進行操作，其 BGA 元件拆焊參數的設定也由鍵盤控制。也可通過電腦 IRsoft 軟體連線，進行溫度及時間的參數設定和修改設定值，及百組以上儲存資料於電腦中。

採用 IR 紅外線燈管溫度感應技術和閉環控制原理，在零件拆取、迴焊過程中，都經由非接觸式紅外線感應器監測 PCB 板及零件溫度。中等波長的紅外線燈管加熱器，具有均勻和安全的加熱系統所需求的功率和靈活性，對於 PCB 需求大熱量及其他無鉛拆焊高溫要求，都可輕易完成 BGA 元件的解焊、迴焊。上部紅外線燈管加熱器可調整加熱光圈視窗系統，可保護 PCB 板上被拆焊元件四周對溫度敏感之元件的熱源防護，而不需更換不同零件尺寸的熱風頭。採用“開放式目視環境”，紅外線無風加熱，不受作業環境及冷機、熱機的溫差影響，拆焊良率 99% 以上。

BGA3500DX -IR規格

IR 紅外線燈管拆焊系統

輸入工作電壓	AC220V/50~60Hz(單相 30A/須接地插)
總功率	6200W(Max)
上部紅外線燈管功率	170W×10=1700W(IR 紅外線燈管/波長約 2~8μ)
底部紅外線燈管功率	500W×9=4500W(IR 紅外線燈管)
上部發熱器尺寸	20mm~90mm(X-Y 方向為可調式視窗)
拆焊 BGA 元件尺寸	2mm×2mm~90mm×90mm
底部紅外線燈管發熱器尺寸	500mm×400mm
承載最大 PC 板尺寸	700mm×680mm
Z 軸最大行程	128mm
Z 軸傳動馬達	步進馬達+PLC
LCD 顯示視窗	67.5×23.5mm/16×2 個字元
上部冷卻風扇	24V/300mA/15CFM
外接 K 型感溫器	3 通道
鐳射對位管	5V/30mA 2 只
保險絲管	5A/220V×2 個；20A/220V×1 個
通訊 IRSOFT 溫度軟體	USB 介面執行通訊協議(可與 PC 聯機/另選購 Win10/64 位元)
紅外線測溫感測器	非接觸式紅外線偵測 BGA 零件溫度/測溫範圍 0~300℃
真空泵	外接乾燥潔淨高壓氣源
尺寸	1200 (L)×990(W)×780(H)mm(含線性滑軌 L/1755mm)
重量	約 180Kg